

## 7. ЯКІСТЬ ПАЯНИХ З'ЄДНАНЬ З ВПРОВАДЖЕННЯМ БЕЗСВИНЦЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Голик В.А. Науковий керівник – проф. каф. “Електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій”, к.т.н. Панов Л.І.

Останнім часом проблеми бессвинцевого паяння спричиняють підвищений інтерес виготівників радіоелектронної техніки. Заборона на застосування свинцю в окремій країні або групі країн неминуче створює економічний бар'єр між цією країною і будь-якою іншою, нездібною забезпечити бессвинцеве виробництво, що не може не викликати занепокоєння тих виготівників радіоелектроніки, які орієнтовані на імпорт своєї продукції.

Серед бессвинцевих сплавів можна виділити групу Sn| /Ag /Cu, що спричиняє останнім часом, підвищену увагу західних виготівників радіоелектроніки як життєздатна заміна олов'яно-свинцевим сплавам.

Треба визнати, що зовнішній вигляд бессвинцевих паяних з'єднань відрізняється від з'єднань, отриманих із застосуванням припоїв Sn| /Pb. Бессвинцеві з'єднання виглядають тьмянішими, та це не означає, що вони менш міцні – скоріше навпаки:

Характеристики	Sn63/ Pb37	Sn/ Ag/ Cu
Розтягування		
Межа міцності при розтягуванні, кПа	33922	39506